

盛合晶微：超越摩尔定律 成为全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业

——盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

盛合晶微半导体有限公司董事长兼首席执行官
盛合晶微半导体有限公司副总裁兼董事会秘书
盛合晶微半导体有限公司副总裁兼首席财务官

崔东先生
周燕女士
赵国红先生

中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理
中国国际金融股份有限公司投资银行部总监

李扬先生
王竹亭女士

盛合晶微半导体有限公司 董事长兼首席执行官崔东先生致辞



人工智能芯片等，通过超越摩尔定律(More than Moore)的异构集成方式，实现高算力、高带宽、低功耗等性能全面提升。

作为中国境内在芯粒多芯片集成封装领域起步最早、技术最先进、生产规模最大、布局最完善的企业之一，盛合晶微坚持以“发展先进的芯粒多芯片集成封装测试一站式服务能力”为总体战略目标，持续推进先进封装技术的迭代升级与规模化应用，不断提升在关键核心技术领域的自主创新能力与产业化水平，在行业内逐步形成了良好的市场口碑，获得了较高的客户认可度，取得了持续快速发展的阶段性成绩。

展望未来，盛合晶微将以本次上市为新起点，紧扣国家集成电路产业发展战略，持续加大研发投入力度，强化关键技术攻关，强化核心竞争优势，继续引领国内先进封装领域的研发、创新，服务产业发展大局，为提升我国集成电路产业链韧性与保障水平贡献更大力量。

我们诚挚地希望通过本次路演，能够解答投资者和朋友们关心的问题，帮助大家更加深入、全面地了解盛合晶微。最后，欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问，谢谢大家！

尊敬的各位投资者、各位线上朋友：

大家下午好！
欢迎大家参加盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演。我谨代表盛合晶微，向长期关心、支持公司发展的投资者、合作伙伴以及各界朋友表示衷心的感谢和热烈的欢迎！
盛合晶微是全球领先的集成电路晶圆级先进封装企业，起步于先进的12英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等先进封装服务，致力于支持各类高性能芯片，尤其是图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)、人

中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理李扬先生致辞



自业务开展之初，盛合晶微即采用前段晶圆制造环节先进的制造和管理体系，并将芯粒多芯片集成封装作为公司发展的方向和目标。目前，盛合晶微已经成为中国境内在芯粒多芯片集成封装领域起步最早、技术最先进、生产规模最大、布局最完善的企业之一，并具备在上述前沿领域追赶全球领先企业的能力。

作为盛合晶微本次发行的保荐机构和主承销商，在与公司的长期合作中，我们见证了公司的高速发展，也切实感受到公司敏锐的战略眼光、精准的行业判断和严谨的工作态度，公司深厚的技术积累和项目储备，为未来持续发展打下了良好基础。我们坚信，以本次发行为契机，并凭借公司在行业内领先的综合竞争力，盛合晶微有望进一步实现创新突破，进入新的发展阶段。

未来，中金公司将切实履行保荐义务，勤勉尽责，持续督导盛合晶微不断完善公司治理，加强投资者关系管理，协助盛合晶微成为上市公司规范运作的典范。

我们衷心地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者能够更加全面、深入、客观地了解盛合晶微，从而更准确地把握盛合晶微的投资价值和投资机会。欢迎各位投资者朋友踊跃提问、建言献策、积极申购。

最后，预祝盛合晶微网上路演圆满成功！谢谢大家！

尊敬的各位投资者、各位线上朋友：

大家好！
欢迎各位参加盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中国国际金融股份有限公司，对所有参与今天网上交流的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎，对长期以来关心和支持盛合晶微的各界朋友表示衷心的感谢！
盛合晶微是全球领先的集成电路晶圆级先进封装企业，起步于先进的12英寸中段硅片加工，并进一步提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等先进封装服务。公司产品的技术水平国内领先，国际先进，为我国集成电路先进封装产业发展作出了重要贡献。

盛合晶微半导体有限公司 副总裁兼董事会秘书周燕女士致结束语



演中心、上海证券报及中国证券网为公司提供良好的沟通平台，谢谢各位！
我们深切感受到大家的关注与期待，很荣幸能够与各位投资者深入交流公司的主营业务、经营业绩、竞争优势和发展战略。希望通过此次交流活动，能够帮助大家更深刻地了解公司的长期价值。真诚地欢迎大家继续关注与支持盛合晶微，我们将全力回报每位投资者朋友对我们的信任。

盛合晶微自成立以来就一直聚焦前沿的先进封装技术，致力于提高中国集成电路产业的自主可控水平。未来，我们将继续坚持长期主义，专注技术创新，充分把握市场机遇，保持企业持续、健康、稳定的发展，使盛合晶微成为一家值得大家信赖、具有长期投资价值的优秀上市公司。

最后，再次感谢各位投资者对盛合晶微的关爱、信任与支持！期待与各位携手同行，共同见证盛合晶微的成长与发展！谢谢大家！

尊敬的各位投资者、各位线上朋友：

大家好！
盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将圆满结束。在此，我谨代表盛合晶微，再次向热情参与本次路演的各位投资者朋友表示最诚挚的感谢！同时，也感谢所有中介机构付出的辛勤劳动！感谢上证路



经营篇

问：公司的主要业务是什么？
周燕：公司是全球领先的集成电路晶圆级先进封装企业，自业务开展之初，公司即采用前段晶圆制造环节先进的制造和管理体系，并将芯粒多芯片集成封装作为公司发展方向和目标。目前，公司已经成为中国境内在芯粒多芯片集成封装领域起步最早、技术最先进、生产规模最大、布局最完善的企业之一，并具备在上述前沿领域追赶全球领先企业的能力。

问：公司的服务可应用于哪些终端领域？
周燕：公司可为高性能运算芯片、智能手机应用处理器、射频芯片、存储芯片、电源管理芯片、指纹识别芯片、网络通信芯片等多类芯片提供一站式定制化的集成电路先进封装服务，应用于高性能运算、人工智能、数据中心、自动驾驶、智能手机、消费电子、5G通信等终端领域，深度参与我国数字化、信息化、网络化、智能化建设。

问：公司有多少家子公司？
崔东：截至2025年6月30日，公司拥有4家控股子公司及1家分公司，无参股公司。

问：请介绍公司的境外经营情况。
崔东：公司的注册地位于开曼群岛，截至2025年6月30日，公司拥有盛合晶微香港和盛合晶微美国两家境外全资子公司。盛合晶微香港未进行实际经营，盛合晶微美国从事市场营销与客户服务业务。

问：公司优质的客户资源有哪些？
崔东：公司已与境内外多家领先芯片设计企业及晶圆制造企业建立了稳定的合作关系，并已成为多家全球领先的智能手机品牌商和计算机、服务器品牌商的供应链企业，曾多次荣获多家行业头部客户授予的优秀供应商或类似奖项。公司已在芯粒多芯片集成封装下游最重要的高算力芯片行业率先实现头部客户的关键突破，并持续提升合作的深度和广度。

问：公司拥有多少知识产权？
赵国红：截至2025年6月30日，公司共有应用于主营业务并能产业化化的境内发明专利157项和境外专利72项，共计229项；公司还拥有33项注册商标、519项境内专利、72项境外专利以及其他商业秘密。

问：请介绍公司主要业务经营和核心技术产业化情况。
赵国红：公司自主研发并形成了涵盖各项主营业务的核心技术，且多项技术和产品填补了我国高端集成电路制造产业链的空白，推动了我国集成电路产业的综合发展，实现了科技成果与产业的深度融合，形成持续大规模的业务收入。根据灼识咨询的统计，截至2024年末，公司是中国境内12英寸Bumping产能规模最大的企业；2024年度，公司是中国境内12英寸WLCSP收入规模和12.5D收入规模最大的企业。

问：请介绍公司的持续经营能力。
赵国红：公司是全球范围内营收规模较大且增长较快的集成电路先进封装企业，在主营业务领域，公司大规模向客户提供的各类服务均在中国市场处于领先地位。报告期内(2022年至2024年及2025年上半年，下同)，公司营业收入分别为163261.51万元、303825.98万元、470539.56万元和317799.62万元，2022年至2024年，复合增长率达69.77%。目前，公司已具备领先的行业地位并实现了高速的业绩成长，且正在持续进行客户拓展、技术升级和产品创新，开展高水平的研发投入和高质量的资本开支，从而巩固行业地位和竞争优势，充分把握市场快速增长的机遇，积极防范和应对各种风险因素，具有良好的持续经营能力。

问：公司的归母净利润是多少？
赵国红：报告期内，公司归母净利润分别为-32857.12万元、3413.06万元、21365.32万元和43489.45万元。

问：公司的综合毛利率是多少？
赵国红：报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为6.85%、21.53%、23.30%和31.64%，呈持续上升趋势，主要系公司产品结构调整、产能利用率、上下游市场供需情况、产品销售价格、成本控制能力等因素综合作用的结果。

问：公司的每股收益是多少？
赵国红：报告期内，公司的基本每股收益分别为-0.42元、0.03元、0.18元和0.27元；稀释后每股收益分别为-0.42元、0.03元、0.17元和0.26元。

问：公司的研发投入是多少？
赵国红：报告期内，公司研发费用分别为25663.42万元、38632.36万元、50560.15万元和36652.11万元，呈现快速增长态势；研发投入占营业收入比例分别为15.72%、12.72%、10.75%和11.53%，持续保持较高水平。

问：公司2026年一季度业绩预计情况如何？
赵国红：基于目前的经营状况和市场环境，公司预计2026年一季度：实现营业收入165000万元至180000万元，较上年同期增长9.91%至19.91%；实现归属于母公司所有者的净利润13500万元至15000万元，较上年同期增长6.93%至18.81%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润13500万元至15000万元，较上年同期增长7.32%至19.24%。

发展篇

问：公司未来的发展战略规划是什么？
崔东：未来，公司将持续创新，采用前段晶圆制造环节先进的制造和管理体系，并根据先进封装的生产工艺特点，不断扩展质量管控的广度和深度，提供一流的中段硅片制造和测试服务，推动先进集成电路制造产业链综合水平的提升。同时，公司还将发挥前中后段芯片制造经验的优势，致力于发展先进的芯粒多芯片集成封装测试一站式服务能力，在后摩尔时代与客户紧密合作，大力投资研发、推动技术进步，满足高算力、高带宽、低功耗等全面性能提升对先进封装的综合性需求。

问：公司的市场拓展计划是什么？
崔东：公司将在稳定现有客户的基础上，加大品牌推广力度，进一步完善公司的营销能力，尤其是基于新技术平台，拓展人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶等高性能运算领域客户，与相关领域的核心客户建立持续合作关系，为公司创造新的经营业绩增长点。

问：公司技术水平的先进性如何？
周燕：基于多年的研发投入和技术积累，公司在各个主营业务领域均形成了一系列具有自主知识产权核心技术的技术平台。根据公司在关键性能指标方面与同行业领先企业的对比情况，公司多个技术平台的核心技术达到“国际领先”水平。公司的核心技术广泛应用于各主营业务中，报告期内，公司的主营业务收入均由核心技术产生，核心技术产生的收入占营业收入的比例均超过99%。

问：公司芯粒多芯片集成封装业务的技术优势是什么？
周燕：在芯粒多芯片集成封装领域，公司拥有可全面对标全球领先企业的技术平台布局，尤其是对于业界最主流的基于硅通孔转接板(TSV Interposer)的2.5D集成(2.5D)，公司是中国境内量产最早、生产规模最大的企业之一，代表中国在该技术领域的最先进水平，且与全球领先企业不存在技术代差。

问：公司的主要优势体现在哪些方面？
李扬：公司起步于先进的12英寸中段硅片加工业务，自业务开展之初即服务于境内外一流客户的高端产品封装需求，并通过前段晶圆制造环节先进的制造和管理体系，充分符合全球领先企业的高标准严要求。此后，公司进一步延伸全流程业务布局、深化客户合作关系、完善制造和管理体系，形成了涵盖销售、生产、采购、研发、管理的全方位竞争优势。得益于此，在目前技术最前沿、市场成长性最高的芯粒多芯片集成封装领域，公司已经成为中国市场的行业引领者，将充分受益于数字经济和人工智能的高速发展。

证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2024年4月修订)》，公司属于“新一代信息技术领域”中“半导体和集成电路”产业。

问：全球先进封装市场未来的增长预期如何？
赵国红：未来，从供给端看，全球晶圆制造产能持续扩充，为封装行业的发展提供了重要基础；从需求端看，数字经济带来人工智能、数据中心、云计算、物联网、虚拟/增强现实等新兴应用场景，也为封装行业发展提供了多元化动力。预计：全球集成电路封装行业市场规模将在2029年达到1349.0亿美元；2024年至2029年，复合增长率为5.9%。同时，先进封装作为后摩尔时代的重要选择，是全球集成电路封装行业未来持续发展的驱动因素，预计：2024年至2029年，全球先进封装市场将保持10.6%的复合增长率，高于传统封装市场2.1%的复合增长率；2029年，全球先进封装占封装市场的比重将达到50.0%。

问：芯粒多芯片集成封装领域的市场增长预期如何？
赵国红：随着人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶、高端消费电子、5G毫米波通信等新兴技术的商用，芯粒多芯片集成封装市场有望呈现快速发展态势。以中国境内为例，根据灼识咨询的统计：2029年，芯粒多芯片集成封装的市场规模将达到176.8亿元；2024年至2029年，复合增长率将达到43.7%。

问：请介绍目前的市场竞争格局和公司的市场地位。
赵国红：近年来，先进封装的市场规模及占总体封装市场的比重均持续上升，吸引了大量的市场参与者。一方面，领先的综合型封装企业凭借强大的资金和技术实力以及优质的客户基础扩大在先进封装环节的投资，另一方面，新兴的先进封装企业凭借在特定领域积累的技术以及吸收的市场投资进入先进封装行业。

在竞争格局中，公司是全球范围内营收规模较大且增长较快的集成电路先进封装企业。根据Gartner的统计，2024年度，公司是全球十大、境内第四大封装企业，且2022年度至2024年度营业收入的复合增长率在全球十大企业中位居第一。在主营业务领域：公司12英寸Bumping产能规模为中国境内最大；2024年度，12英寸WLCSP收入规模和2.5D收入规模均排名中国市场第一，市场占有率分别约为31%和85%，代表中国境内企业在相关技术领域的最先进水平。

问：请介绍公司的控股股东和实控人。
崔东：最近两年内，公司无控股股东且无实际控制人。

问：公司此次发行选择的上市标准是什么？
王竹亭：公司本次发行选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条的第二套标准“预计市值不低于人民币50亿元，且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。

问：公司本次发行的股票类型、每股面值是什么？
崔东：公司本次发行的股票类型为人民币普通股(A股)，每股面值为0.00001美元。公司本次发行的股票以美元为面值币种，以人民币为股票交易币种在上交所科创板进行交易。

问：公司本次发行多少股？
崔东：公司本次公开发行股票数量为25546.6162万股，占本次发行后总股本的比例约为13.71%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。发行后公司总股本为186277.4097万股。

问：公司本次募集资金的主要投资方向是什么？
崔东：公司本次募集资金将投资于三维多芯片集成封装项目和超高密度互联三维多芯片集成封装项目，用于形成多个芯粒多芯片集成封装技术平台的规模产能，并补充配套的凸块制造产能。

问：请介绍“三维多芯片集成封装项目”和“超高密度互联三维多芯片集成封装项目”情况？
周燕：“三维多芯片集成封装项目”计划总投资额为84.00亿元，拟投入募集资金为40亿元；“超高密度互联三维多芯片集成封装项目”计划总投资额为30.00亿元，拟投入募集资金为8亿元。

发行篇

问：请介绍公司所属行业。
赵国红：根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”之“电子器件制造(C397)”；根据《国民经济行业分类目录》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”之“集成电路制造(C3973)”；根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)，公司属于“新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.4集成电路制造”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)，公司属于“新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.1集成电路”；根据《上海